

2015年(平成27年)3月期 決算説明会

2015年5月15日

株式会社フジミインコーポレーテッド

目 次

✓決算概要	P. 2
✓用途別売上高	P. 10
✓設備投資額・減価償却費・研究開発費	P. 19
✓損益分析・人員	P. 24
✓補足説明資料・マーケットデータ等	P. 28

決算概要

決算概要(通期実績)

百万円	14年3月期	15年3月期			
	通期実績	通期予想 (' 15/2)	通期実績	前期比	予想比 (' 15/2)
売上高	27,492	32,000	32,815	+19.4%	+2.5%
営業利益	1,300	3,400	4,128	+217.4%	+21.4%
営業利益率	4.7%	10.6%	12.6%	—	—
経常利益	1,535	3,700	4,596	+199.4%	+24.2%
経常利益率	5.6%	11.6%	14.0%	—	—
当期純利益	799	3,000	3,695	+362.3%	+23.2%

決算概要(半期実績)

百万円	14年3月期		15年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
売上高	13,994	13,498	16,363	+16.9%	+21.2%	16,451	+21.9%	+0.5%
営業利益	668	631	2,033	+204.2%	+221.8%	2,094	+231.4%	+3.0%
営業利益率	4.8%	4.7%	12.4%	-	-	12.7%	-	-
経常利益	781	754	2,236	+186.3%	+196.5%	2,359	+212.9%	+5.5%
経常利益率	5.6%	5.6%	13.7%	-	-	14.3%	-	-
当期純利益	533	266	1,858	+248.6%	+598.5%	1,836	+590.1%	△1.2%

決算概要(四半期実績)

百万円	14年3月期	15年3月期					
	4Q 実績	1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績	4Q 実績	前年 同期比	同年 3Q比
売上高	6,727	7,543	8,820	8,366	8,085	+20.2%	△3.4%
営業利益	241	857	1,175	1,177	917	+279.2%	△22.1%
営業利益率	3.6%	11.4%	13.3%	14.1%	11.3%	-	-
経常利益	190	877	1,358	1,347	1,012	+432.4%	△24.9%
経常利益率	2.8%	11.6%	15.4%	16.1%	12.5%	-	-
当期純利益	30	720	1,138	946	890	29倍	△5.9%

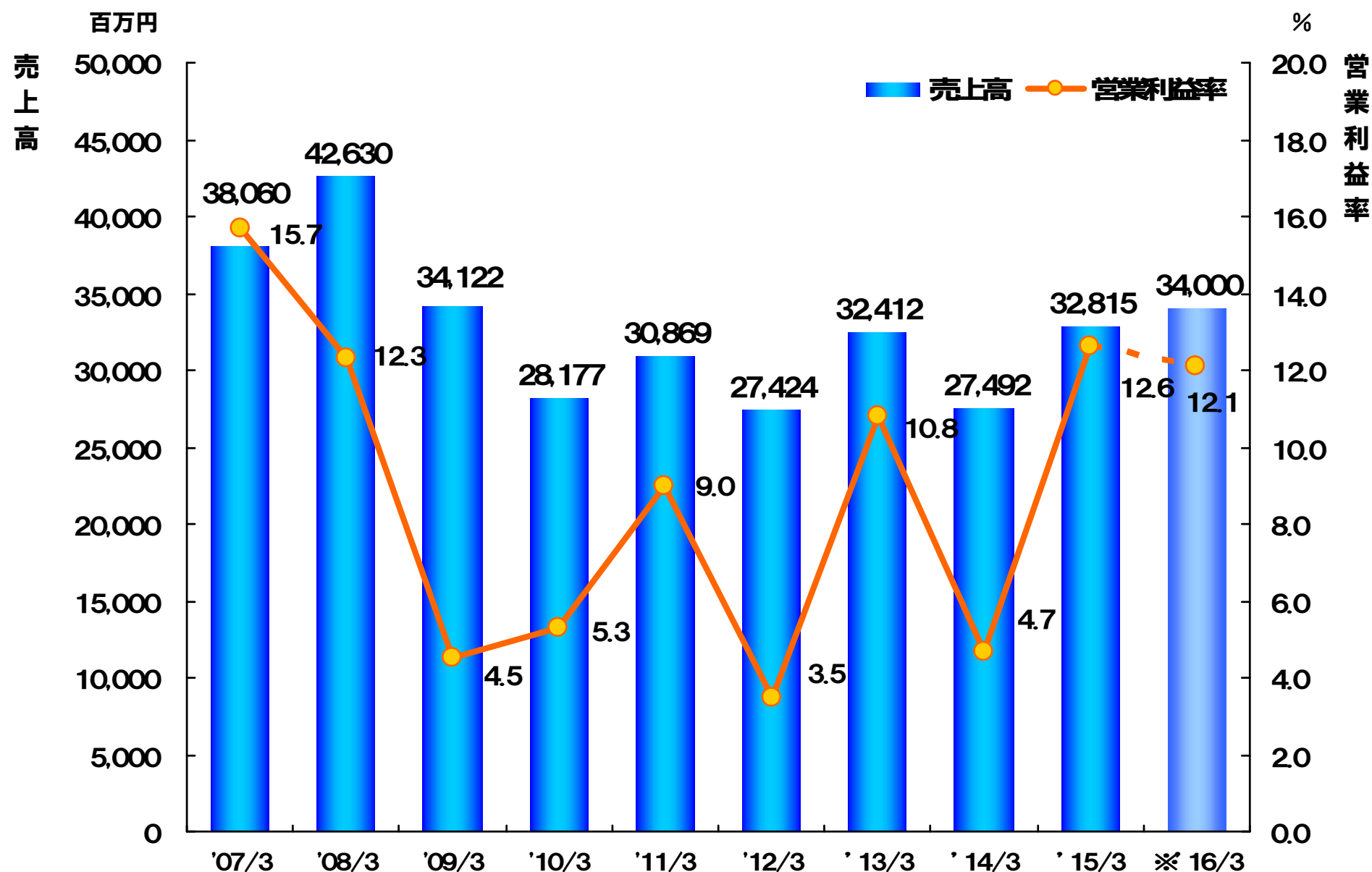
業績予想(通期)

百万円	14年3月期	15年3月期	16年3月期	
	通期実績	通期実績	通期予想	前期比
売上高	27,492	32,815	34,000	+3.6%
営業利益	1,300	4,128	4,100	△0.7%
営業利益率	4.7%	12.6%	12.1%	—
経常利益	1,535	4,596	4,200	△8.6%
経常利益率	5.6%	14.0%	12.4%	—
当期純利益	799	3,695	3,100	△16.1%

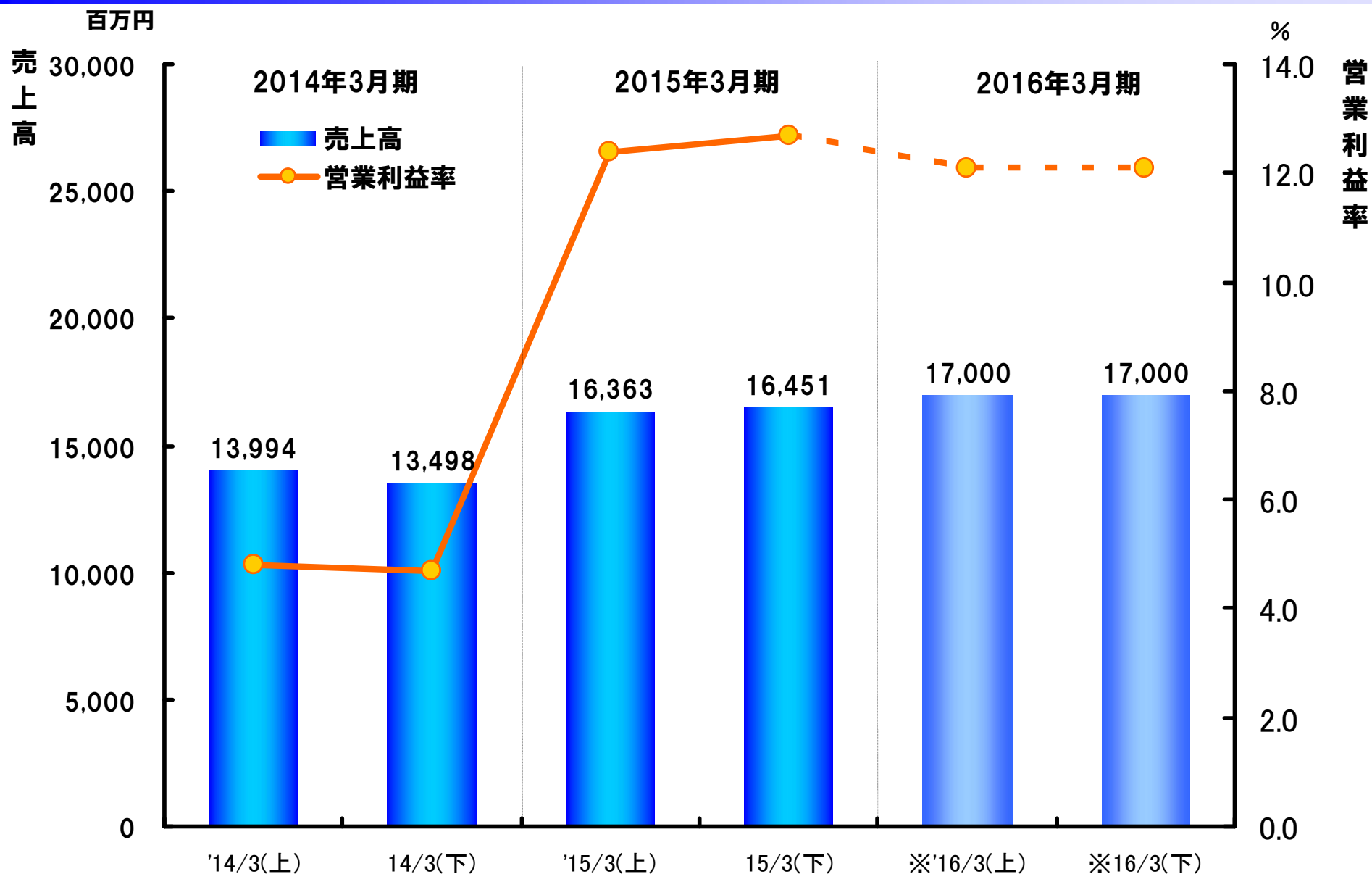
業績予想(半期)

百万円	15年3月期		16年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比
売上高	16,363	16,451	17,000	+3.9%	+3.3%	17,000	+3.3%
営業利益	2,033	2,094	2,050	+0.8%	△2.1%	2,050	△2.1%
営業利益率	12.4%	12.7%	12.1%	-	-	12.1%	-
経常利益	2,236	2,359	2,100	△6.1%	△11.0%	2,100	△11.0%
経常利益率	13.7%	14.3%	12.4%	-	-	12.4%	-
当期純利益	1,858	1,836	1,550	△16.6%	△15.6%	1,550	△15.6%

業績推移（通期）



業績推移（半期）



用途別売上高

用途別売上高(通期実績)

百万円		14年3月期	15年3月期	
		通期実績	通期実績	前期比
シリコン	ラッピング	2,978	3,277	+10.0%
	ポリシング	5,351	5,871	+9.7%
	切断	538	403	△25.0%
	計	8,868	9,552	+7.7%
CMP		8,224	10,143	+23.3%
ディスク	アルミディスク	2,130	2,916	+36.8%
	ガラスディスク	527	562	+6.6%
	計	2,658	3,478	+30.9%
機能材料・溶射材	一般工業用(研磨材)	6,182	7,788	+26.0%
	一般工業用(研磨材以外)	1,259	1,564	+24.2%
	計	7,443	9,353	+25.7%
製品売上高		27,192	32,527	+19.6%
商品売上高		299	287	△4.2%
売上高 合計		27,492	32,815	+19.4%

用途別売上高(半期実績)

百万円		14年3月期		15年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
シリコン	ラッピング	1,557	1,421	1,667	+7.1%	+17.3%	1,609	+13.3%	△3.4%
	ポリシング	2,767	2,584	3,024	+9.3%	+17.0%	2,847	+10.2%	△5.9%
	切断	220	317	223	+1.5%	△29.6%	180	△43.3%	△19.5%
	計	4,545	4,323	4,915	+8.1%	+13.7%	4,637	+7.3%	△5.7%
CMP		4,186	4,038	4,888	+16.8%	+21.1%	5,254	+30.1%	+7.5%
ディスク	アルミディスク	956	1,174	1,302	+36.1%	+10.9%	1,613	+37.4%	+23.9%
	ガラスディスク	228	298	275	+20.2%	△7.7%	286	△3.8%	+4.2%
	計	1,185	1,472	1,577	+33.1%	+7.2%	1,900	+29.1%	+20.5%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,327	2,855	4,083	+22.7%	+43.0%	3,705	+29.8%	△9.3%
	一般工業用(研磨材以外)	631	628	722	+14.4%	+14.9%	842	+34.0%	+16.7%
	計	3,958	3,483	4,805	+21.4%	+37.9%	4,547	+30.5%	△5.4%
製品売上高		13,875	13,317	16,187	+16.7%	+21.6%	16,340	+22.7%	+0.9%
商品売上高		119	180	176	+48.2%	△2.4%	110	△38.7%	△37.2%
売上高 合計		13,994	13,498	16,363	+16.9%	+21.2%	16,451	+21.9%	+0.5%

用途別売上高(通期予想)

百万円		14年3月期	15年3月期	16年3月期	
		通期実績	通期実績	通期予想	前期比
シリコン	ラッピング	2,978	3,277	3,304	+0.8%
	ポリシング	5,351	5,871	6,067	+3.3%
	切断	538	403	337	△16.5%
	計	8,868	9,552	9,708	+1.6%
CMP		8,224	10,143	11,288	+11.3%
ディスク	アルミディスク	2,130	2,916	2,958	+1.4%
	ガラスディスク	527	562	552	△1.7%
	計	2,658	3,478	3,510	+0.9%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	6,182	7,788	7,820	+0.4%
	一般工業用(研磨材以外)	1,259	1,564	1,410	△9.9
	計	7,443	9,353	9,231	△1.3%
製品売上高		27,192	32,527	33,739	+3.7%
商品売上高		299	287	261	△8.9%
売上高 合計		27,492	32,815	34,000	+3.6%

用途別売上高(半期予想)

百万円		15年3月期		16年3月期					
		上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
シリコン	ラッピング	1,667	1,609	1,656	△0.6%	+2.9%	1,647	+2.3%	△0.6%
	ポリシング	3,024	2,847	2,855	△5.6%	+0.3%	3,211	+12.8%	+12.5%
	切断	223	180	168	△24.7%	△6.4%	168	△6.3%	+0.1%
	計	4,915	4,637	4,680	△4.8%	+0.9%	5,028	+8.4%	+7.4%
CMP		4,888	5,254	5,633	+15.2%	+7.2%	5,655	+7.6%	+0.4%
ディスク	アルミディスク	1,302	1,613	1,465	+12.5%	△9.2%	1,492	△7.5%	+1.8%
	ガラスディスク	275	286	279	+1.4%	△2.7%	273	△4.7%	△2.1%
	計	1,577	1,900	1,744	+10.6%	△8.2%	1,765	△7.1%	+1.2%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,083	3,705	4,124	+1.0%	+11.3%	3,696	△0.2%	△10.4%
	一般工業用(研磨材以外)	722	842	687	△4.9%	△18.4%	723	△14.2%	+5.2%
	計	4,805	4,547	4,811	+0.1%	+5.8%	4,419	△2.8%	△8.1%
製品売上高		16,187	16,340	16,870	+4.2%	+3.2%	16,869	+3.2%	△0.0%
商品売上高		176	110	130	△26.0%	+17.8%	131	+18.3%	+0.4%
売上高 合計		16,363	16,451	17,000	+3.9%	+3.3%	17,000	+3.3%	±0%

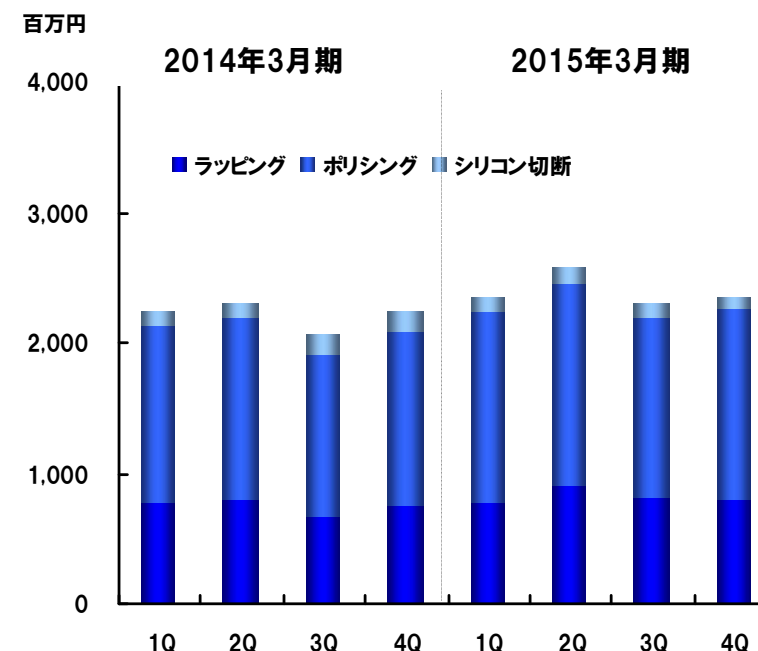
シリコン売上高(通期実績・予想、半期実績・予想)

《通期》

百万円		14年3月期	15年3月期		16年3月期	
		通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
シリコン	ラッピング	2,978	3,277	+10.0%	3,304	+0.8%
	ポリシング	5,351	5,871	+9.7%	6,067	+3.3%
	切断	538	403	△25.0%	337	△16.5%
	計	8,868	9,552	+7.7%	9,708	+1.6%

《半期》

百万円		14年3月期		15年3月期		16年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
シリコン	ラッピング	1,557	1,421	1,667	1,609	1,656	1,647
	ポリシング	2,767	2,584	3,024	2,847	2,855	3,211
	切断	220	317	223	180	168	168
	計	4,545	4,323	4,915	4,637	4,680	5,028



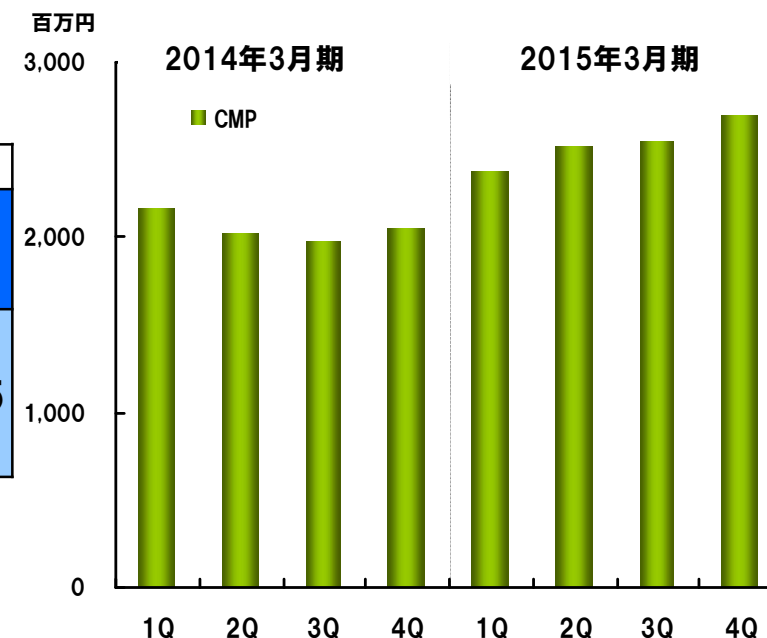
CMP売上高(通期実績・予想、半期実績・予想)

《通期》

百万円	14年3月期	15年3月期		16年3月期	
	通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
CMP	8,224	10,143	+23.3%	11,288	+11.3%

《半期》

百万円	14年3月期		15年3月期		16年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
CMP	4,186	4,038	4,888	5,254	5,633	5,655



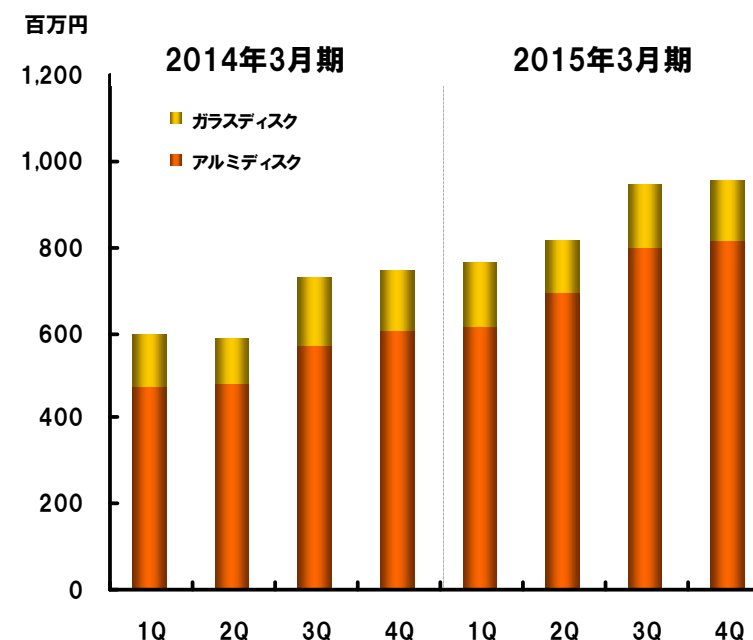
ディスク売上高(通期実績・予想、半期実績・予想)

《通期》

百万円		14年3月期	15年3月期		16年3月期	
		通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
ディスク	アルミディスク	2,130	2,916	+36.8%	2,958	+1.4%
	ガラスディスク	527	562	+6.6%	552	△1.7%
	計	2,658	3,478	+30.9%	3,510	+0.9%

《半期》

百万円		14年3月期		15年3月期		16年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
ディスク	アルミディスク	956	1,174	1,302	1,613	1,465	1,492
	ガラスディスク	228	298	275	286	279	273
	計	1,185	1,472	1,577	1,900	1,744	1,765



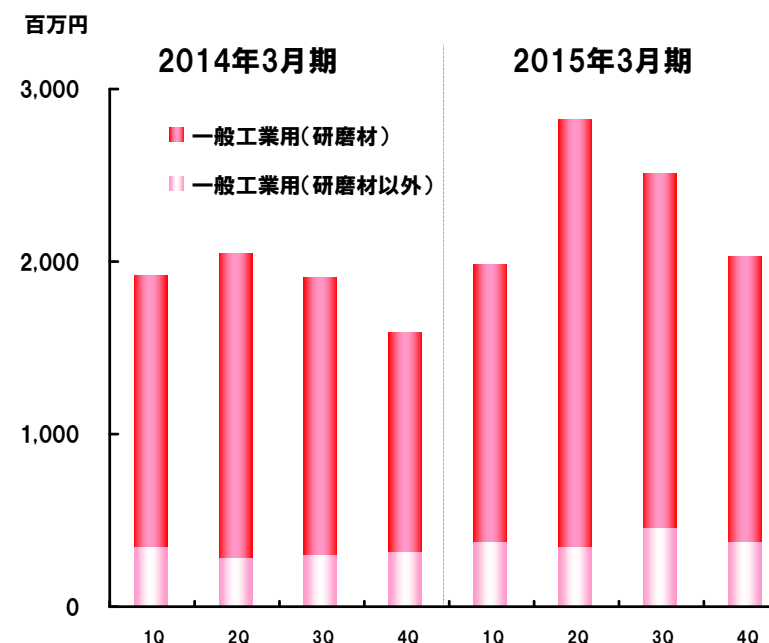
機能材・溶射材売上高(通期実績・予想、半期実績・予想)

《通期》

百万円		14年3月期	15年3月期		16年3月期	
		通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	6,182	7,788	+26.0%	7,820	+0.4%
	一般工業用(研磨材以外)	1,259	1,564	+24.2%	1,410	△9.9%
	計	7,443	9,353	+25.7%	9,231	△1.3%

《半期》

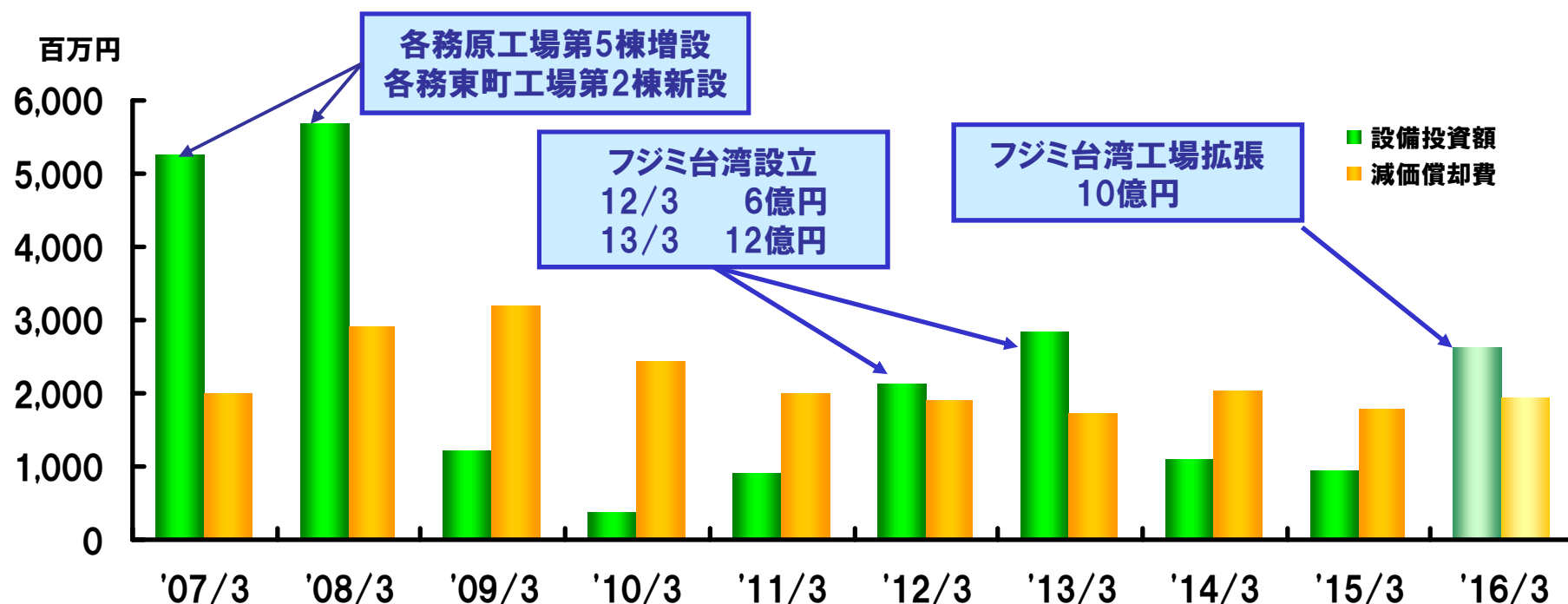
百万円		14年3月期		15年3月期		16年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,327	2,855	4,083	3,705	4,124	3,696
	一般工業用(研磨材以外)	631	628	722	842	687	723
	計	3,958	3,483	4,805	4,547	4,811	4,419



設備投資額 減価償却費 研究開発費

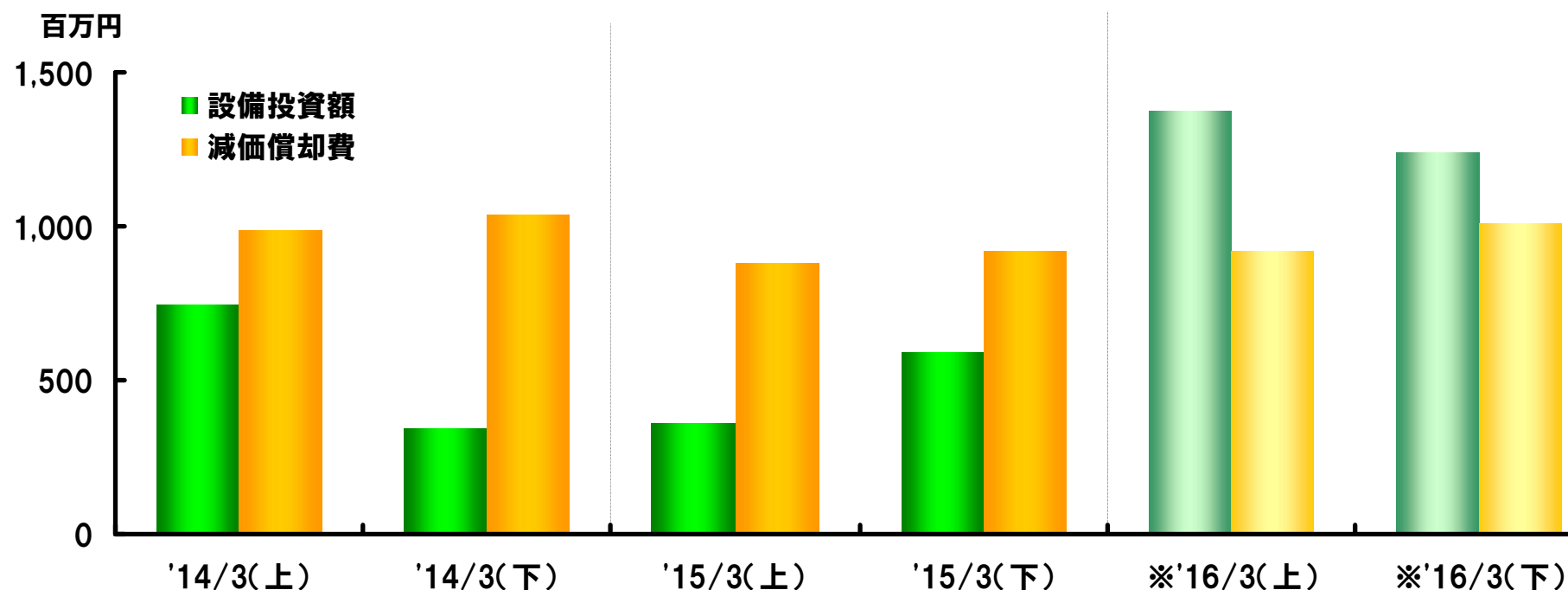
設備投資額・減価償却費(通期実績・通期計画)

百万円	14年3月期	15年3月期		16年3月期	
	通期実績	通期実績	前期比	通期計画	前期比
設備投資額	1,094	947	△13.4%	2,611	+175.7%
減価償却費	2,022	1,794	△11.3%	1,923	+7.2%



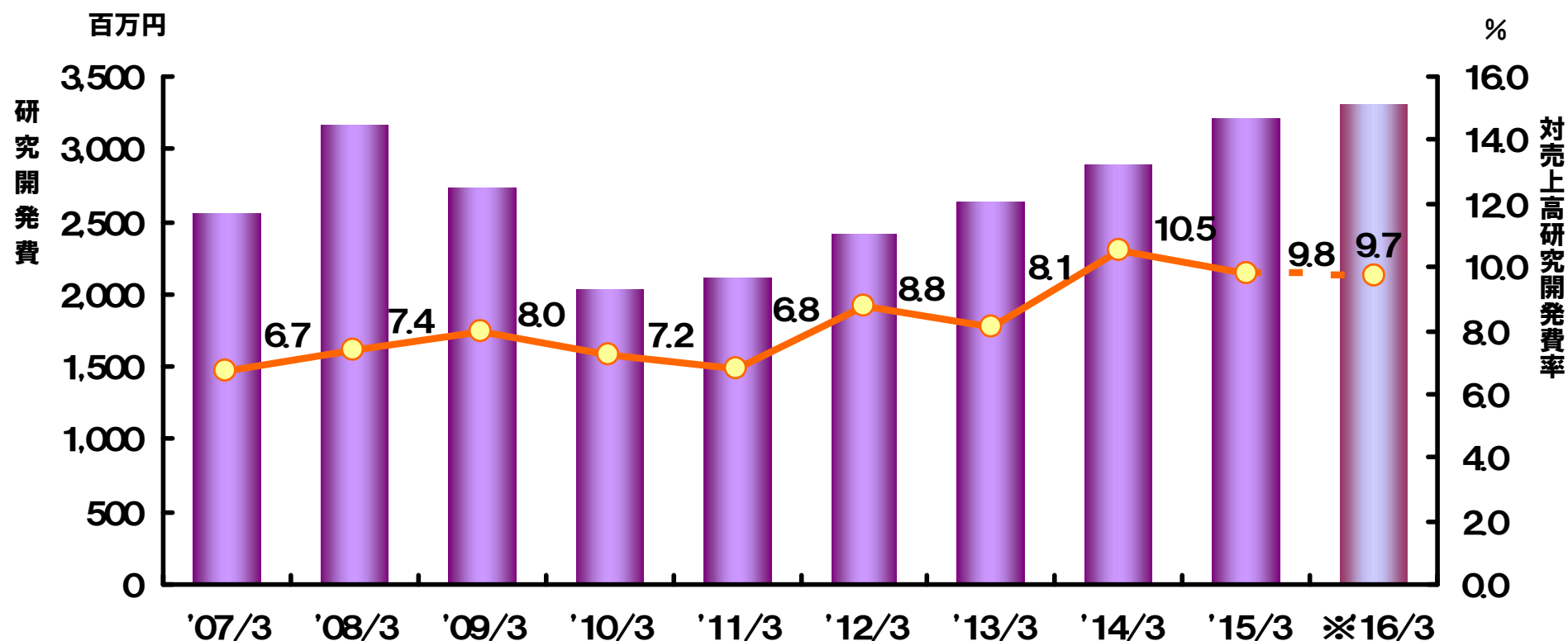
設備投資額・減価償却費(半期実績・半期計画)

百万円	14年3月期		15年3月期				16年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	前年同期比	同年上期比	上期計画	前年同期比	前年下期比	下期計画	前年同期比	同年上期比
設備投資額	748	345	359	588	+70.1%	+63.7%	1,374	+282.6%	133.8%	1,237	+110.4%	△10.0%
減価償却費	985	1,036	878	916	△11.6%	+4.3%	916	+4.4%	+0.1%	1,006	+9.9%	+9.8%



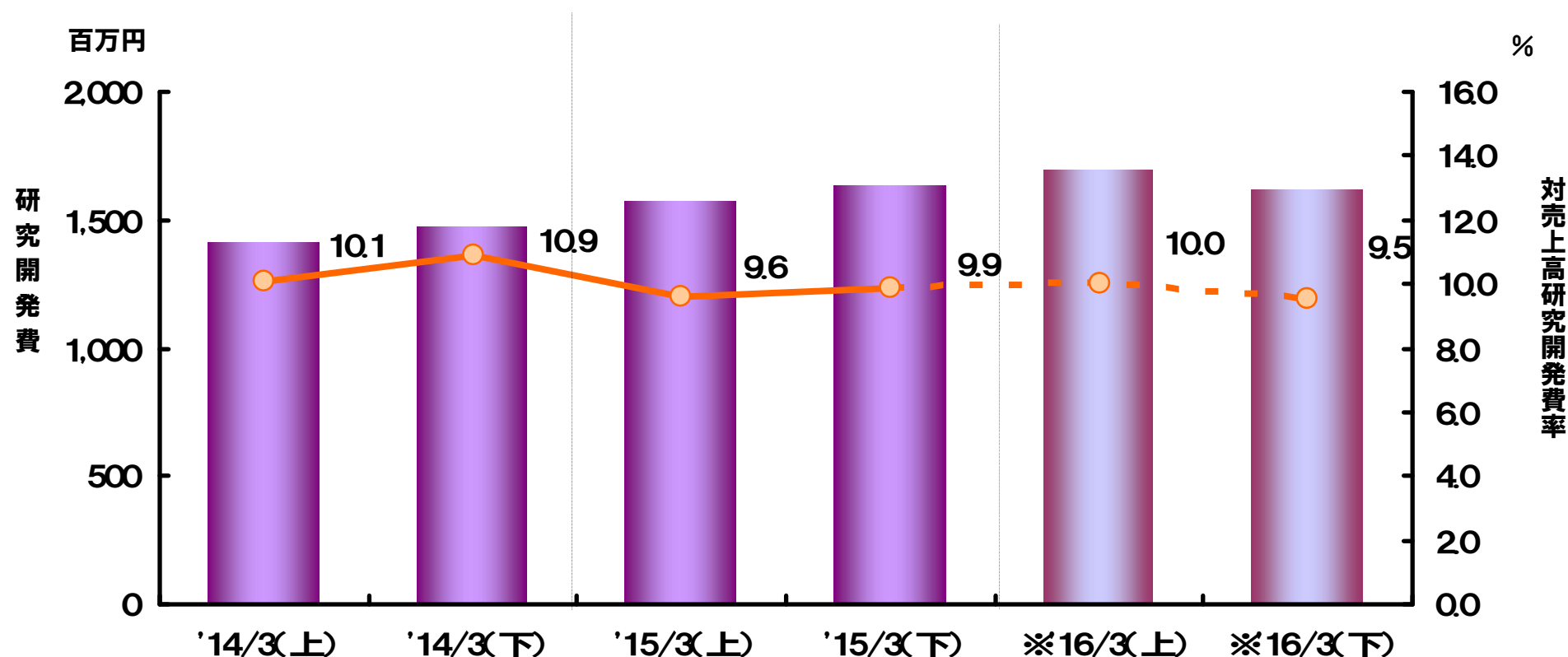
研究開発費／対売上高研究開発費率（通期実績・通期計画）

百万円	14年3月期	15年3月期		16年3月期	
	通期実績	通期実績	前期比	通期計画	前期比
研究開発費	2,885	3,210	+11.2%	3,311	+3.1%



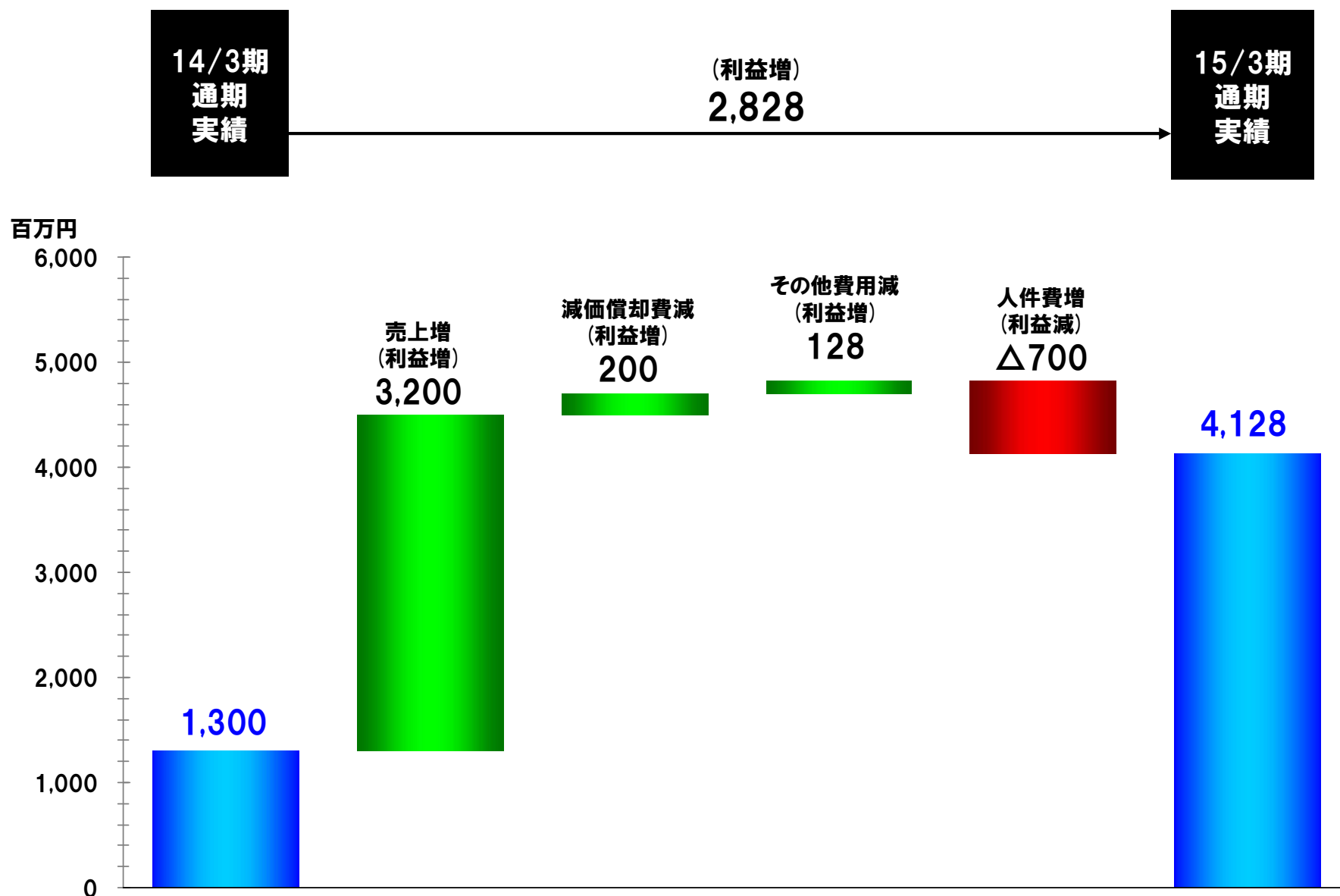
研究開発費／対売上高研究開発費率（半期実績・半期計画）

百万円	14年3月期		15年3月期				16年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	前年同期比	同年上期比	上期計画	前年同期比	前年下期比	下期計画	前年同期比	同年上期比
研究開発費	1,410	1,475	1,574	1,636	+10.9%	+3.9%	1,692	+7.5%	+3.4%	1,619	△1.0%	△4.3%

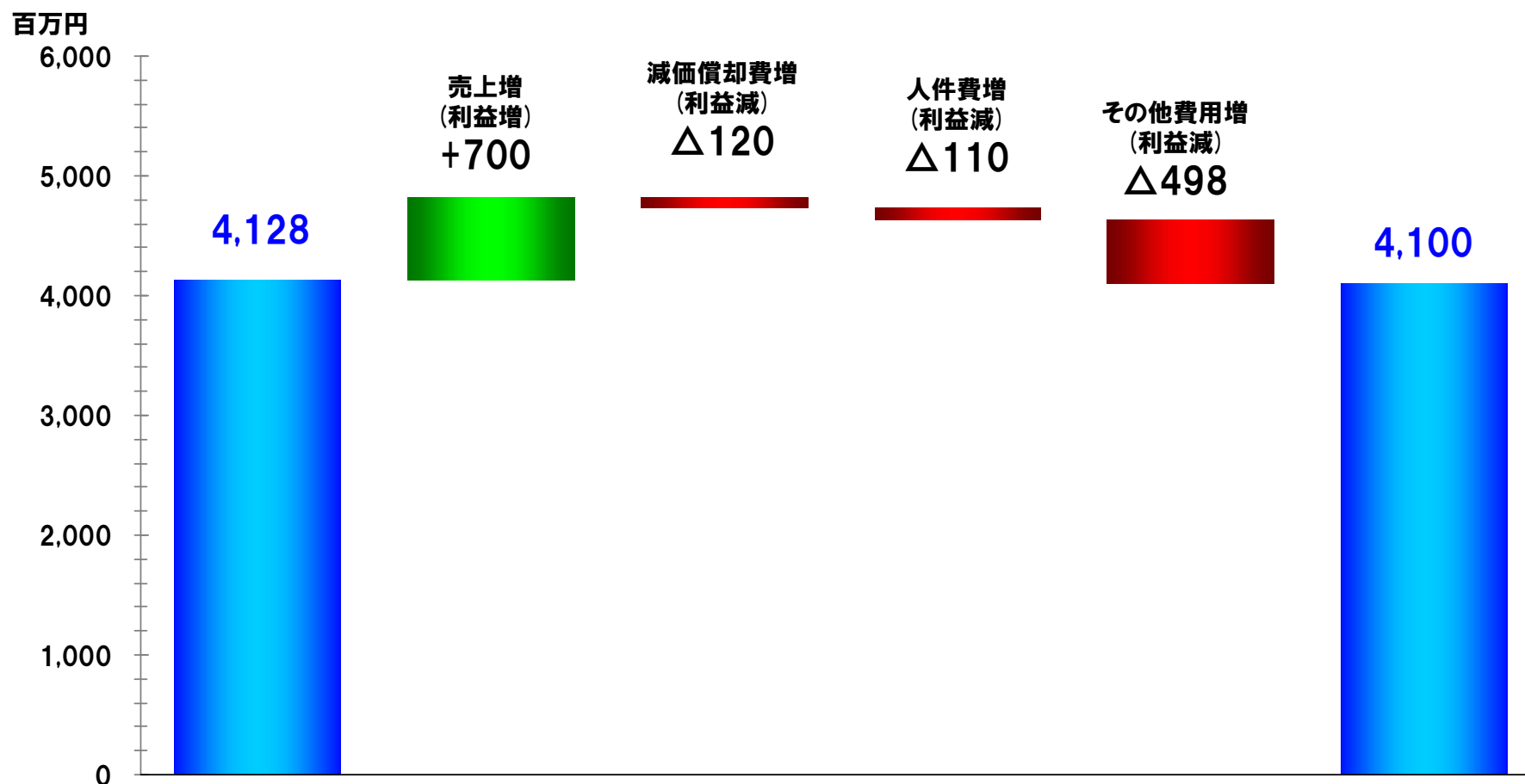


損益分析・人員

営業利益増減要因 14/3期通期実績→15/3期通期実績



営業利益増減要因 15/3期通期実績→16/3期通期予想

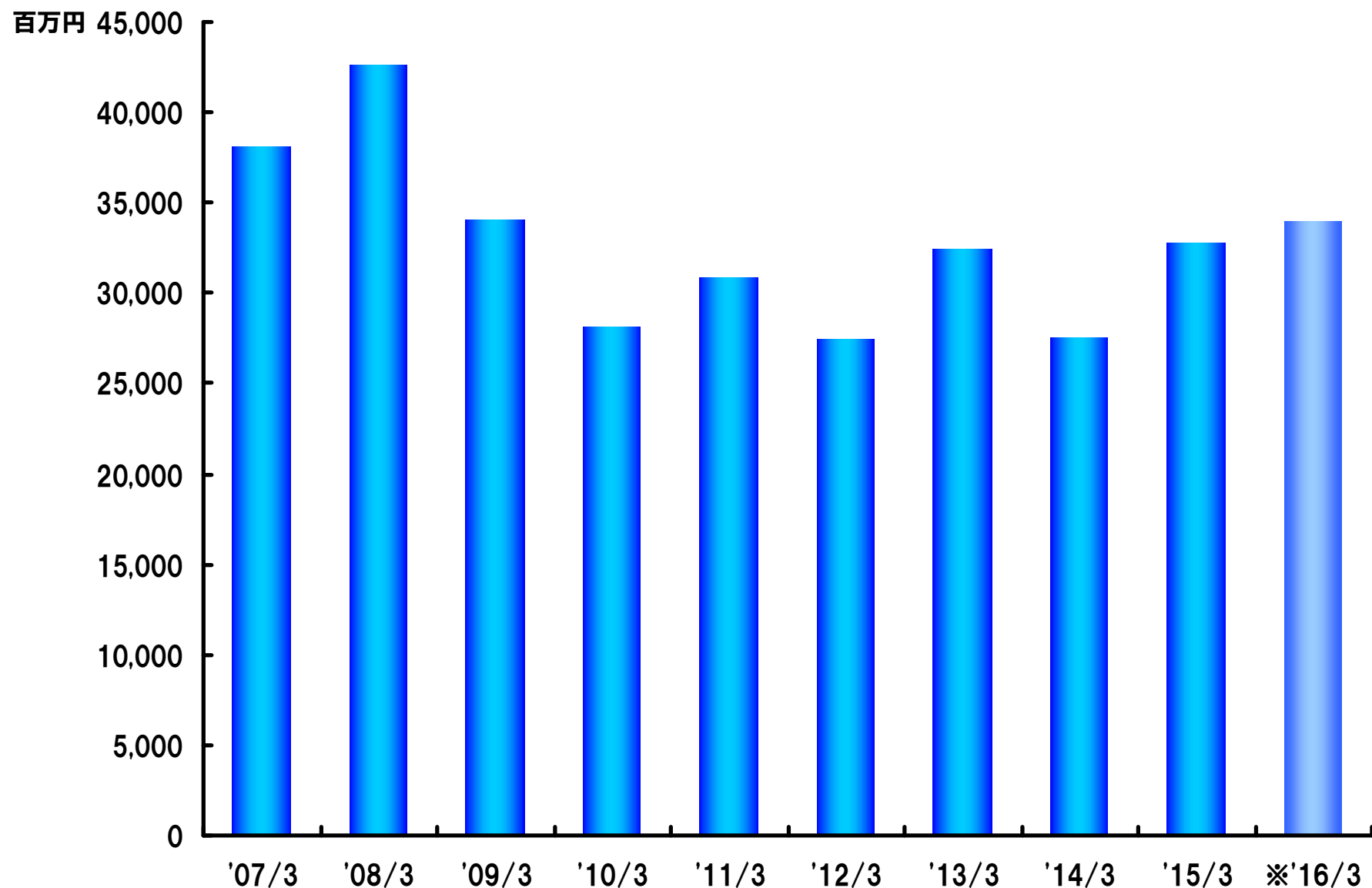


グループ人員 内訳

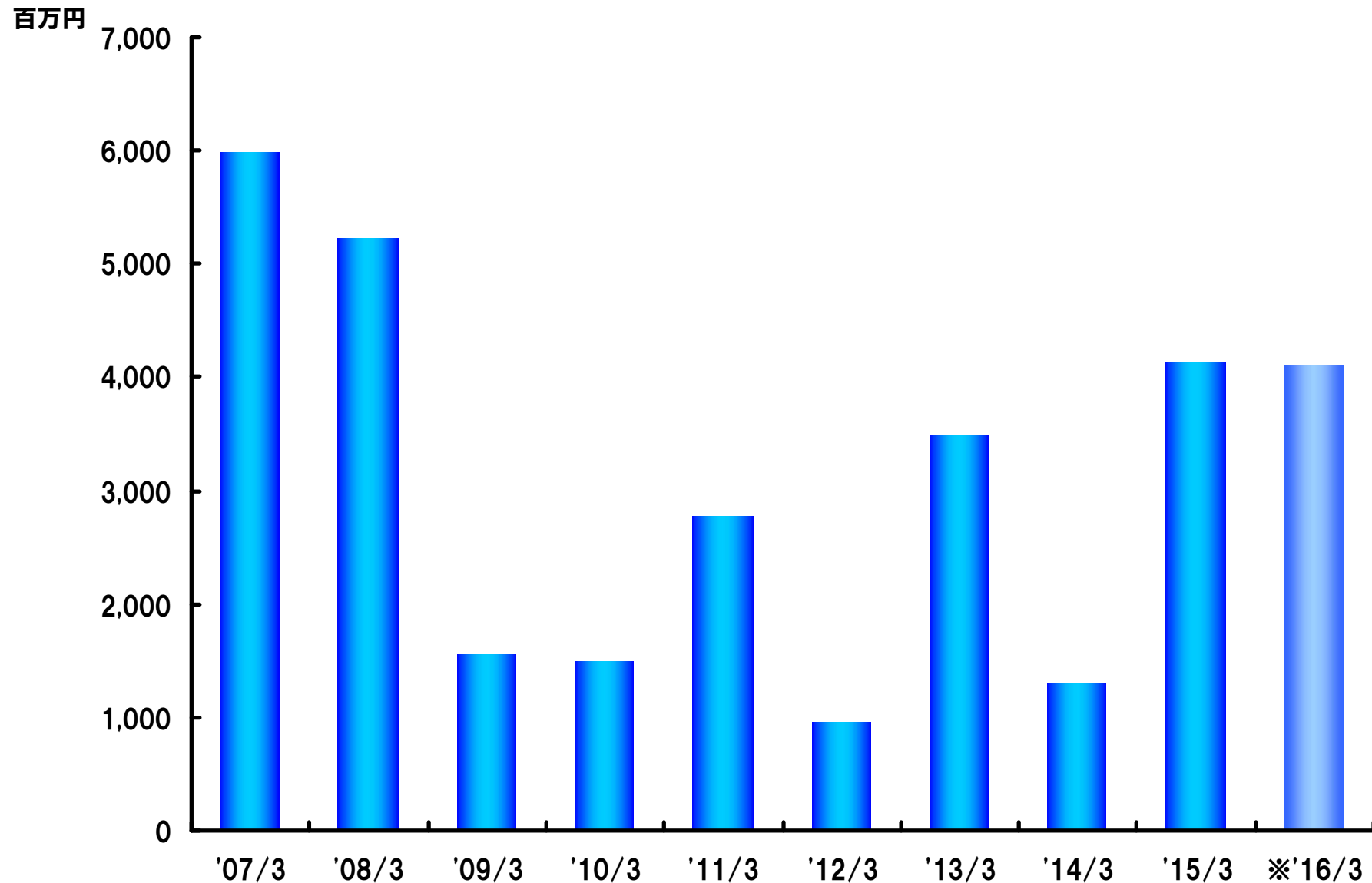
(人数)	14年3月期 (3月31日現在)		15年3月期 (3月31日現在)			
	正社員	臨時 雇用者 ※	正社員	臨時 雇用者 ※	前年同期増減	
					正社員	臨時 雇用者
フジミインコーポレーテッド	557	128	554	131	-3	+3
フジミコーポレーション	98	5	107	1	+9	-4
フジミ台湾	52	1	71	1	+19	—
フジミマイクロテクノロジー	60	1	58	4	-2	+3
フジミヨーロッパ	5	1	4	1	-1	—
フジミ韓国	3	0	3	0	—	—
フジミ深圳	—	—	1	0	+1	—
合 計	775	136	798	138	+23	+2

補足説明資料 マーケットデータ等

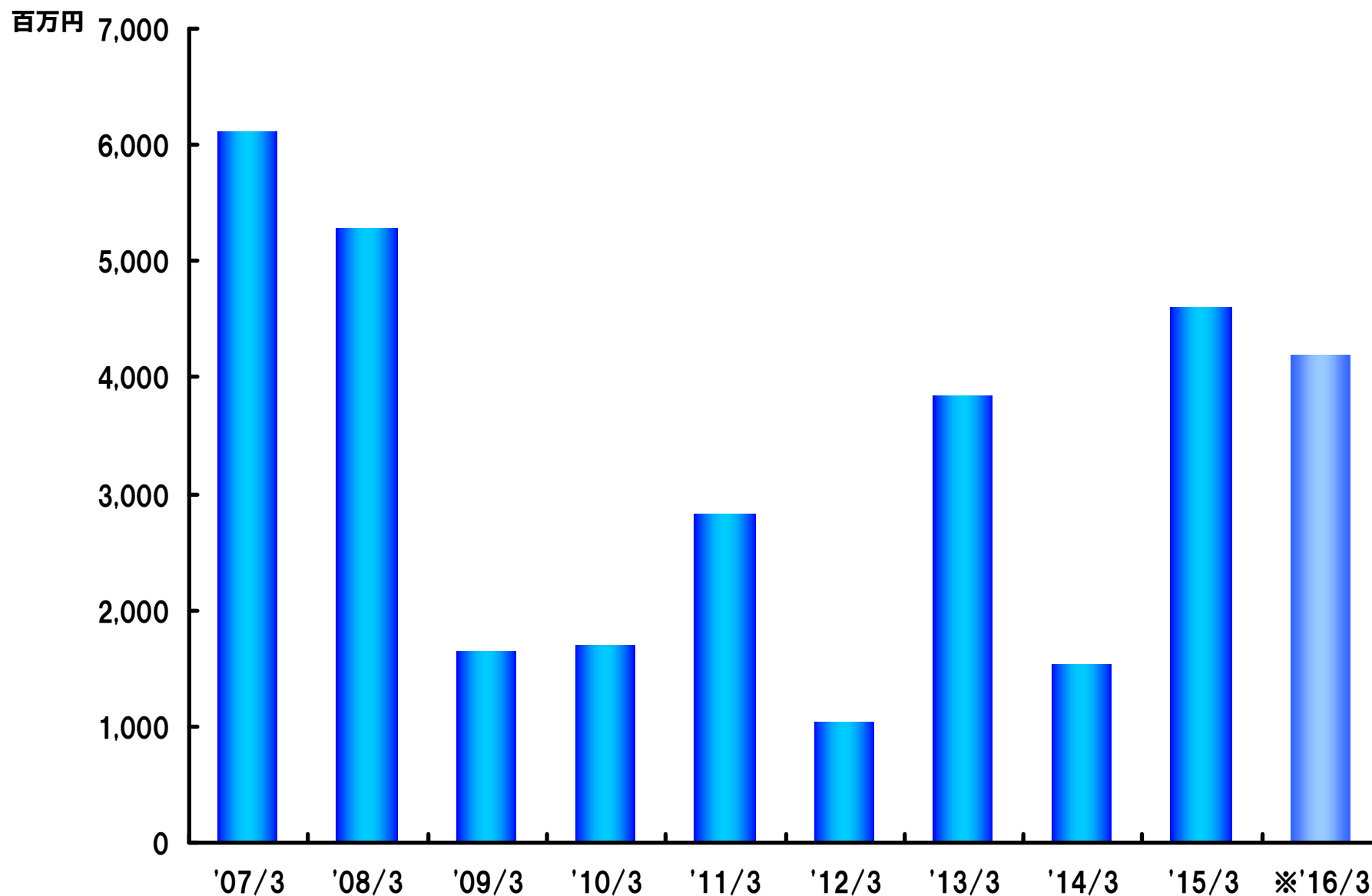
売上高(通期)



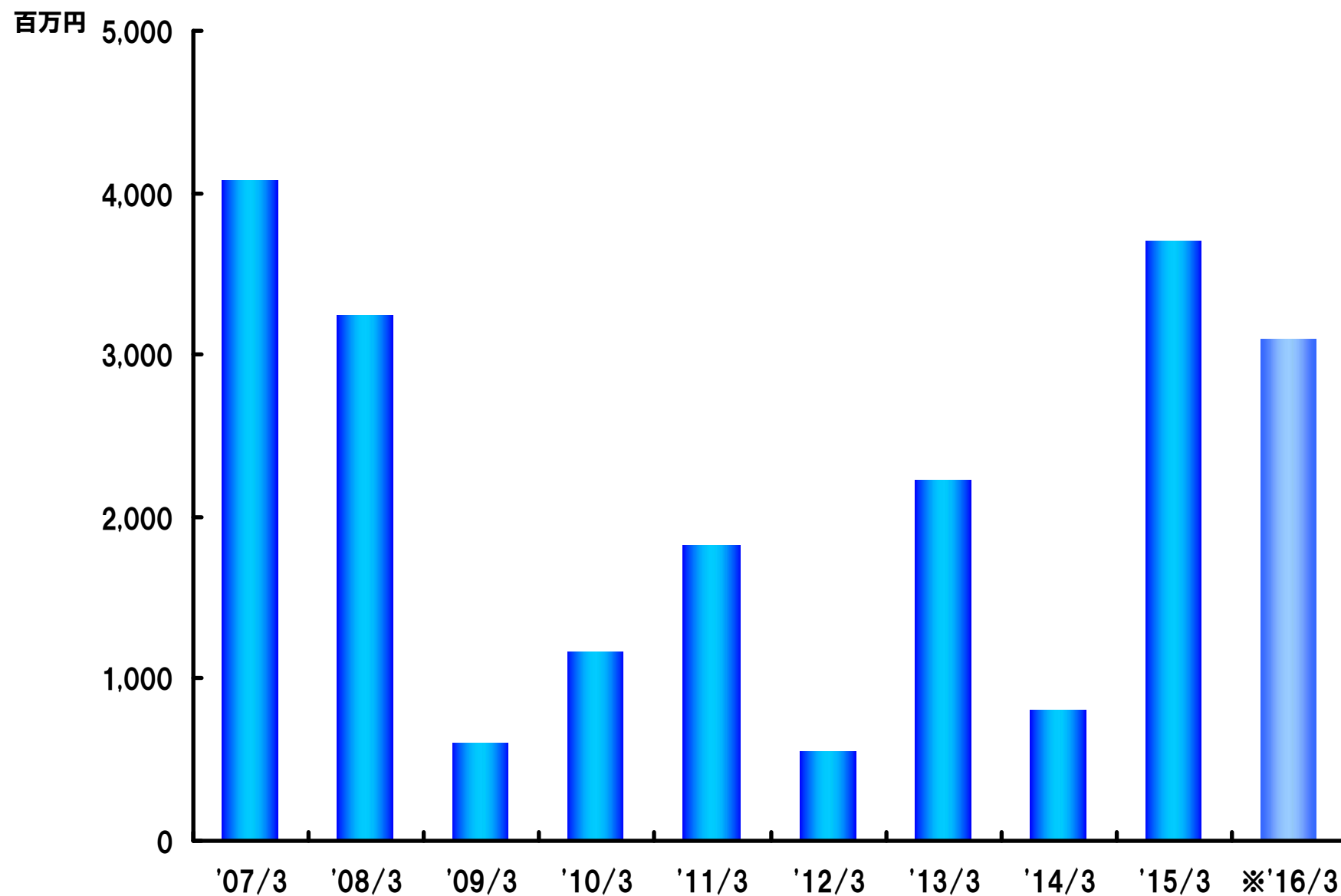
営業利益(通期)



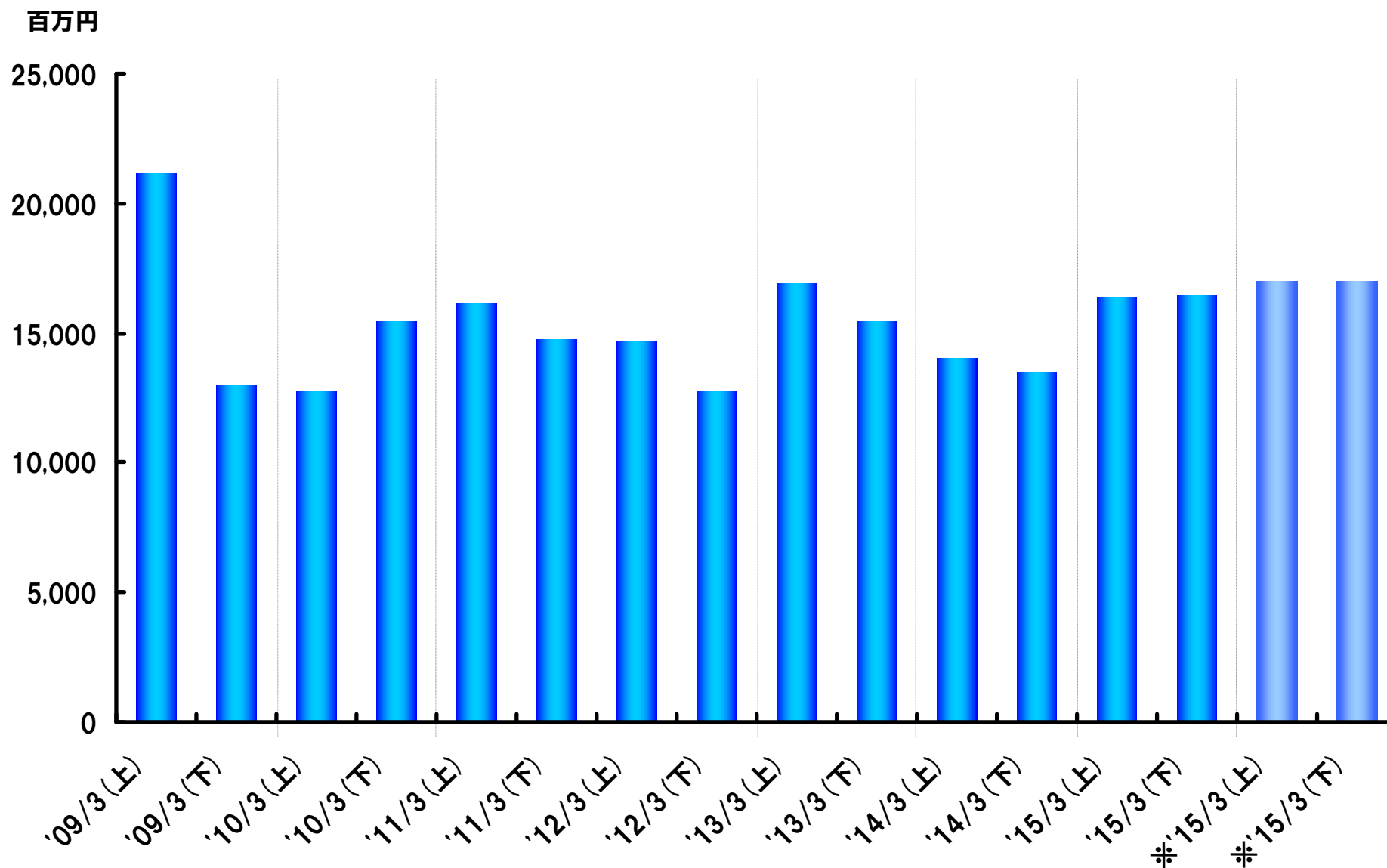
経常利益(通期)



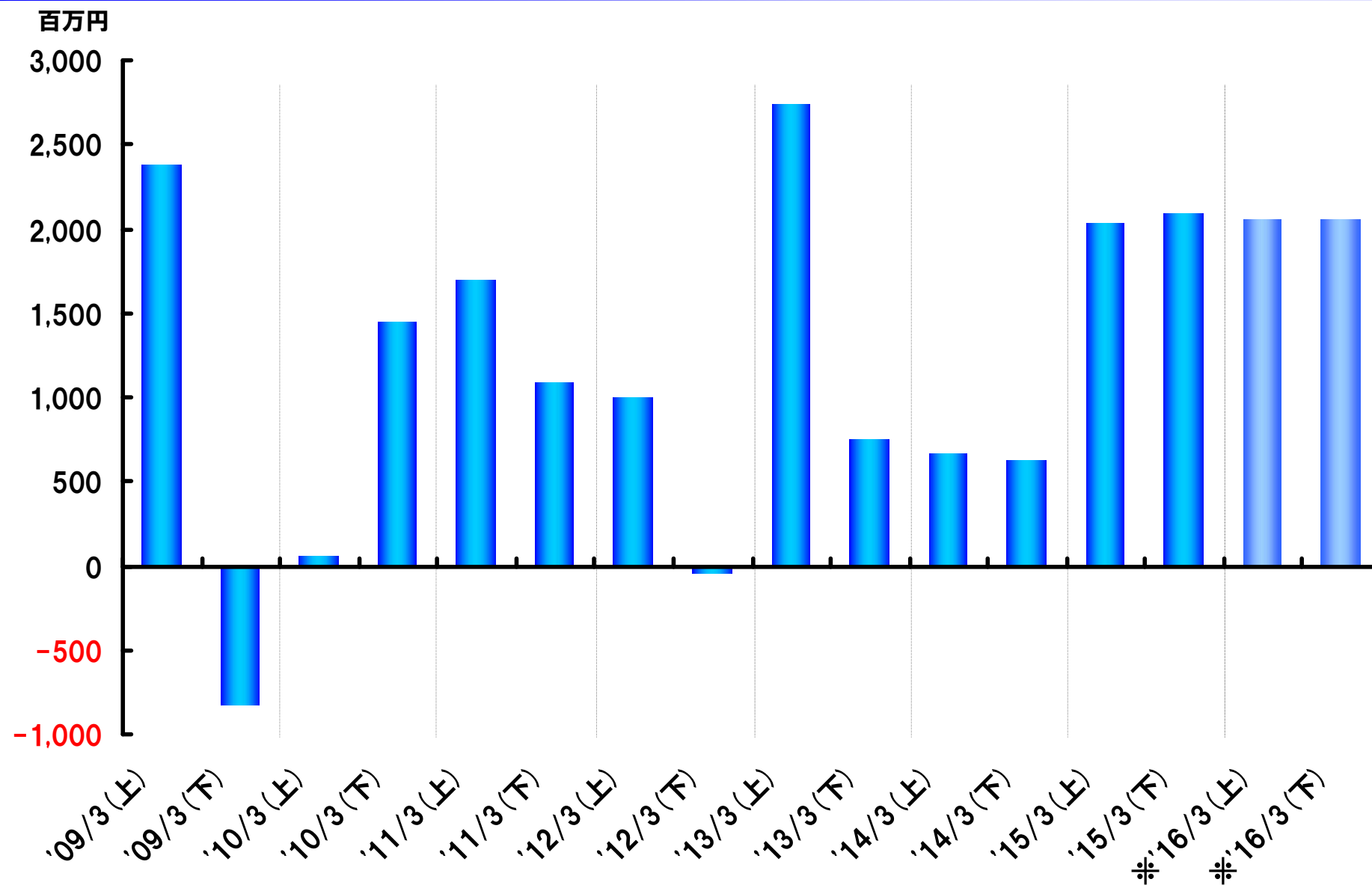
当期純利益(通期)



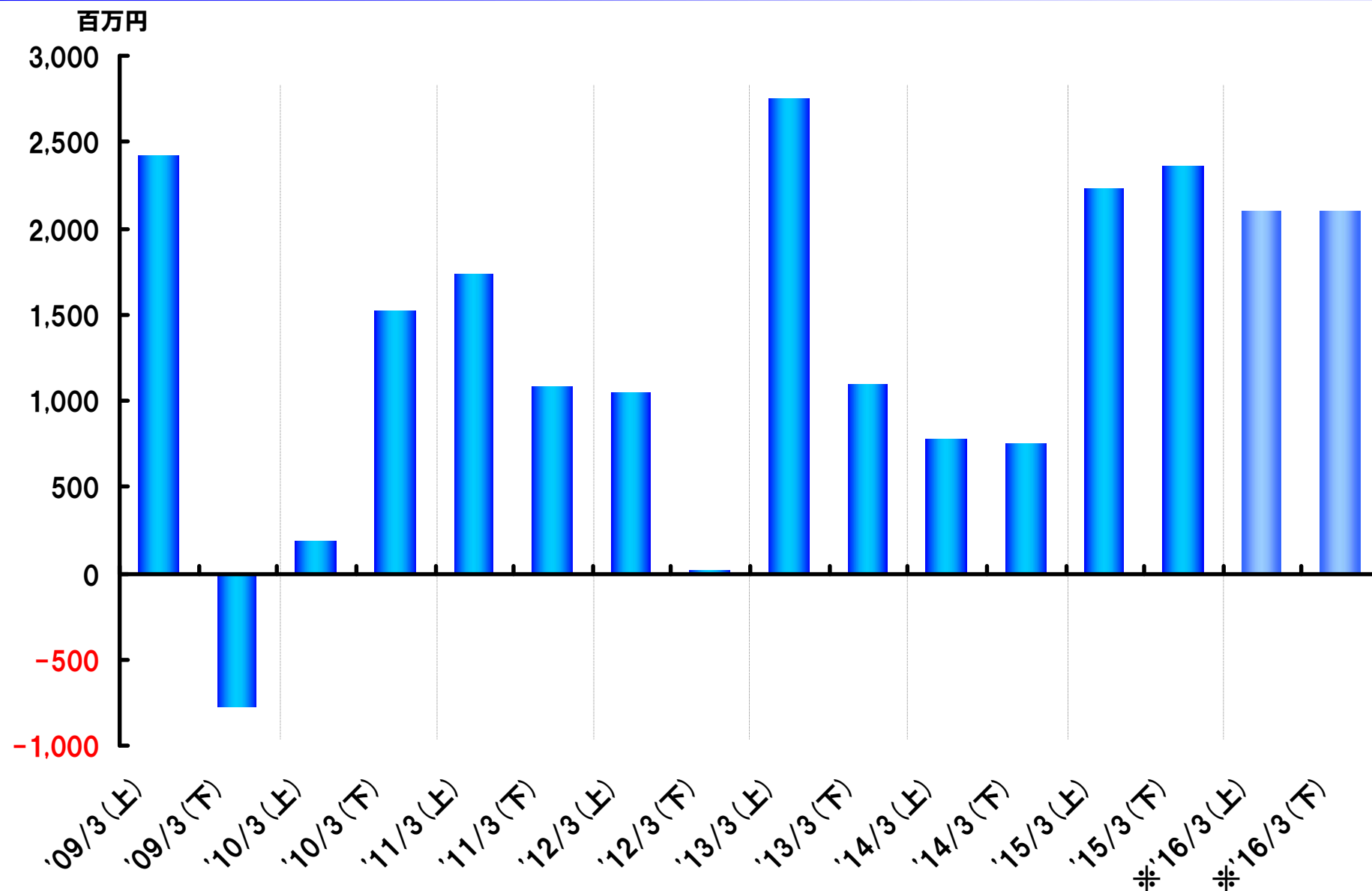
売上高(半期)



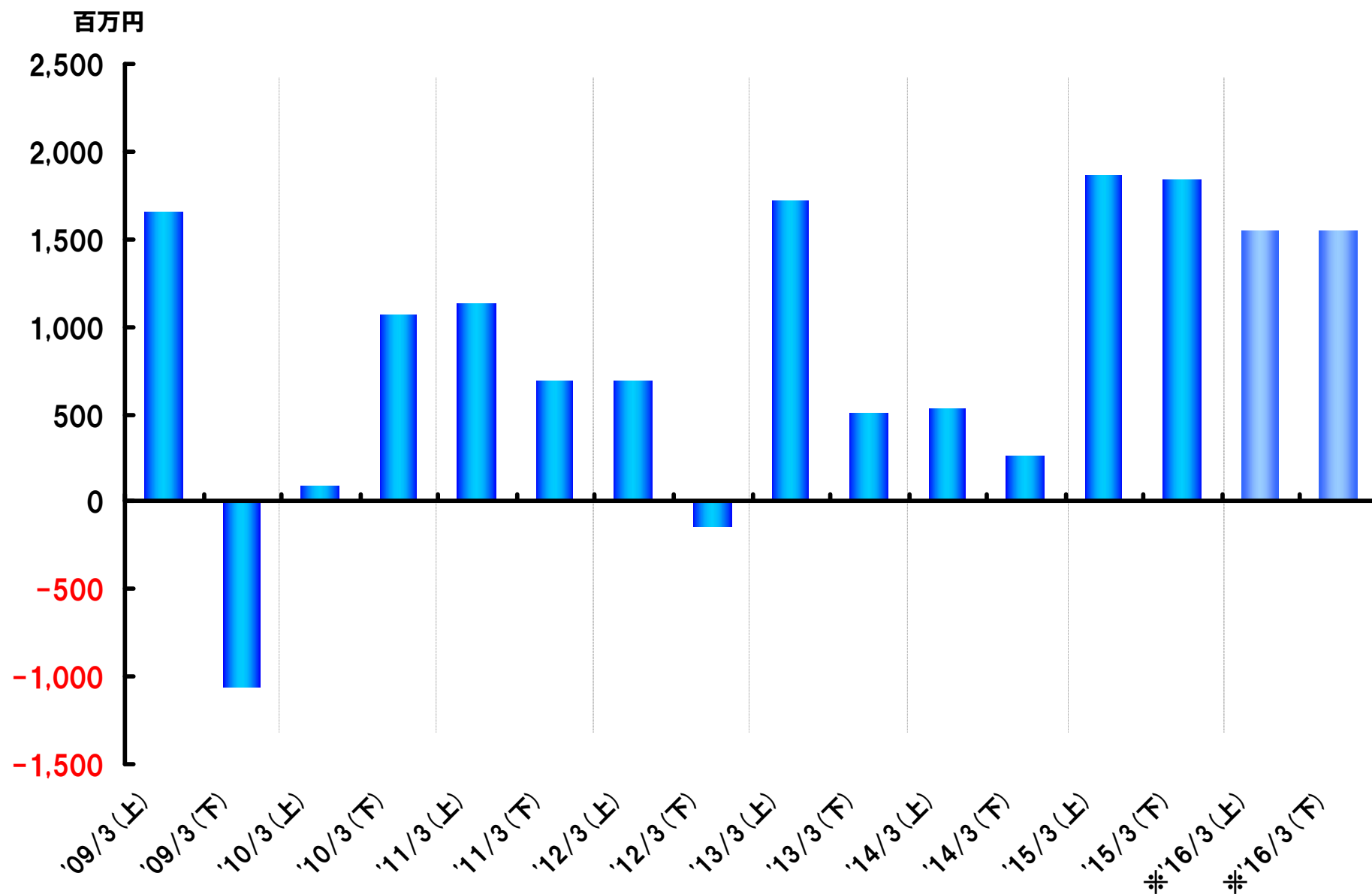
営業利益(半期)



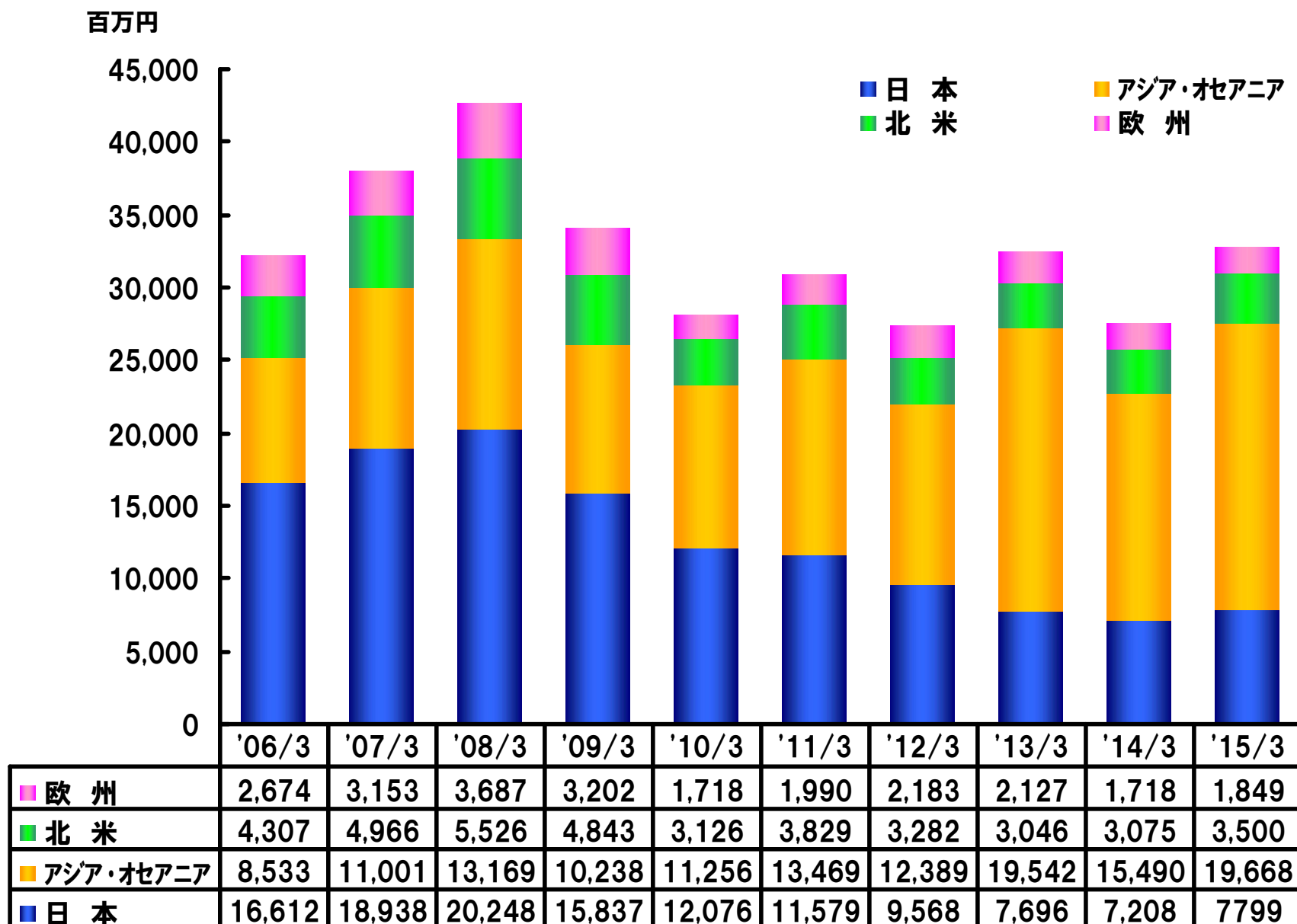
経常利益(半期)



当期純利益（半期）

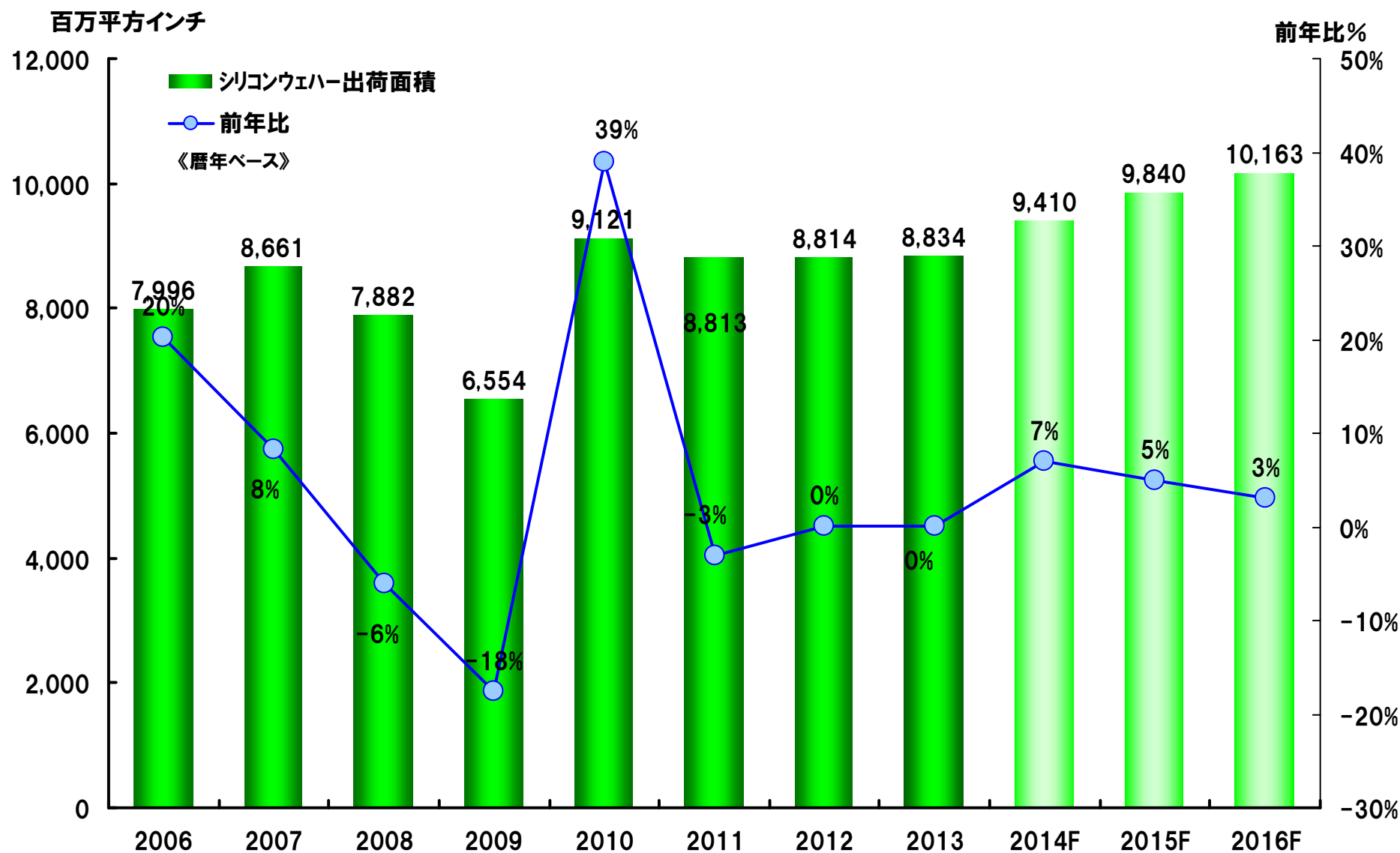


地域別売上高（通期）



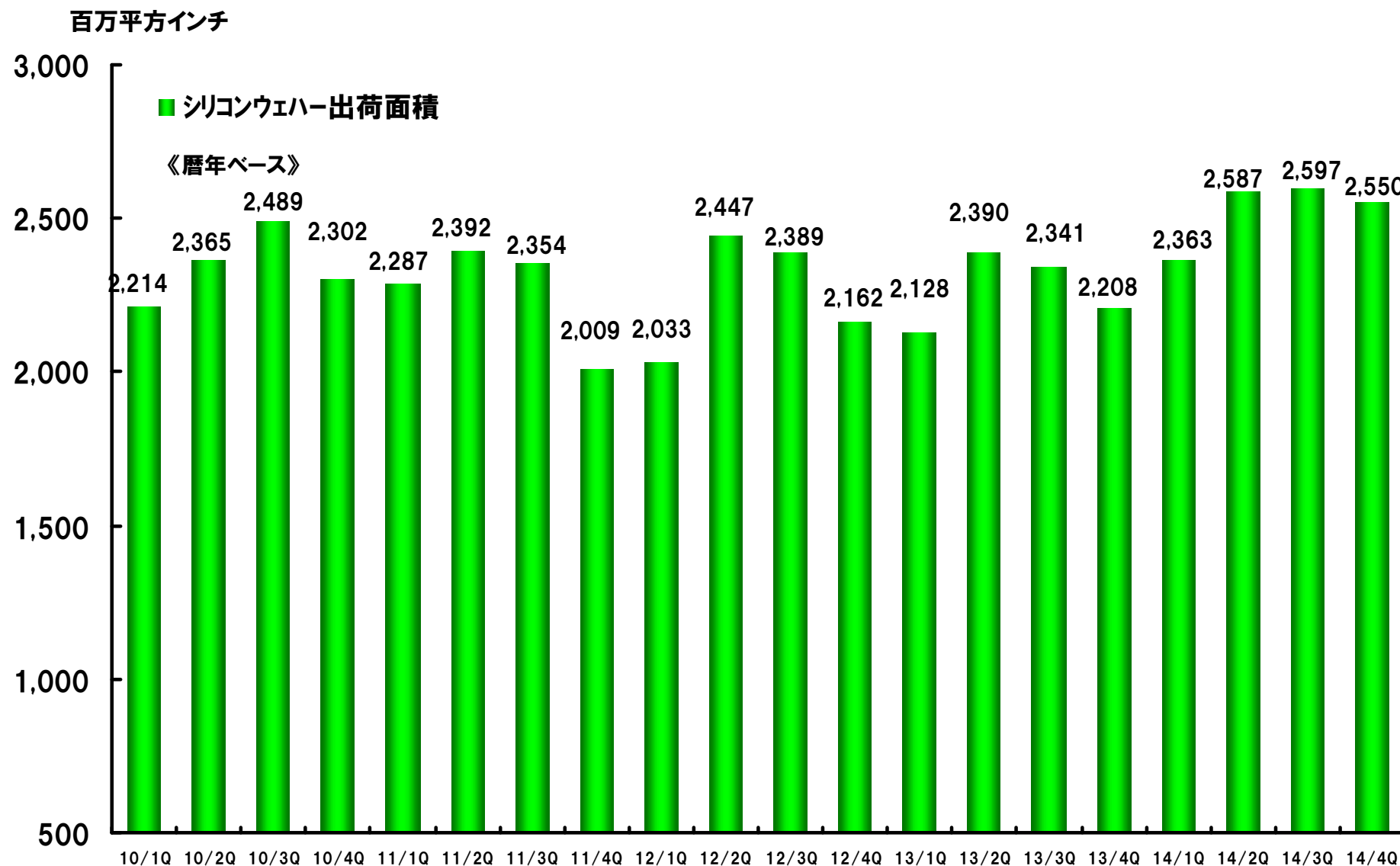
シリコンウェハー出荷面積(暦年)

※ノンポリッシュは含まない



出所: SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International) 2014年10月

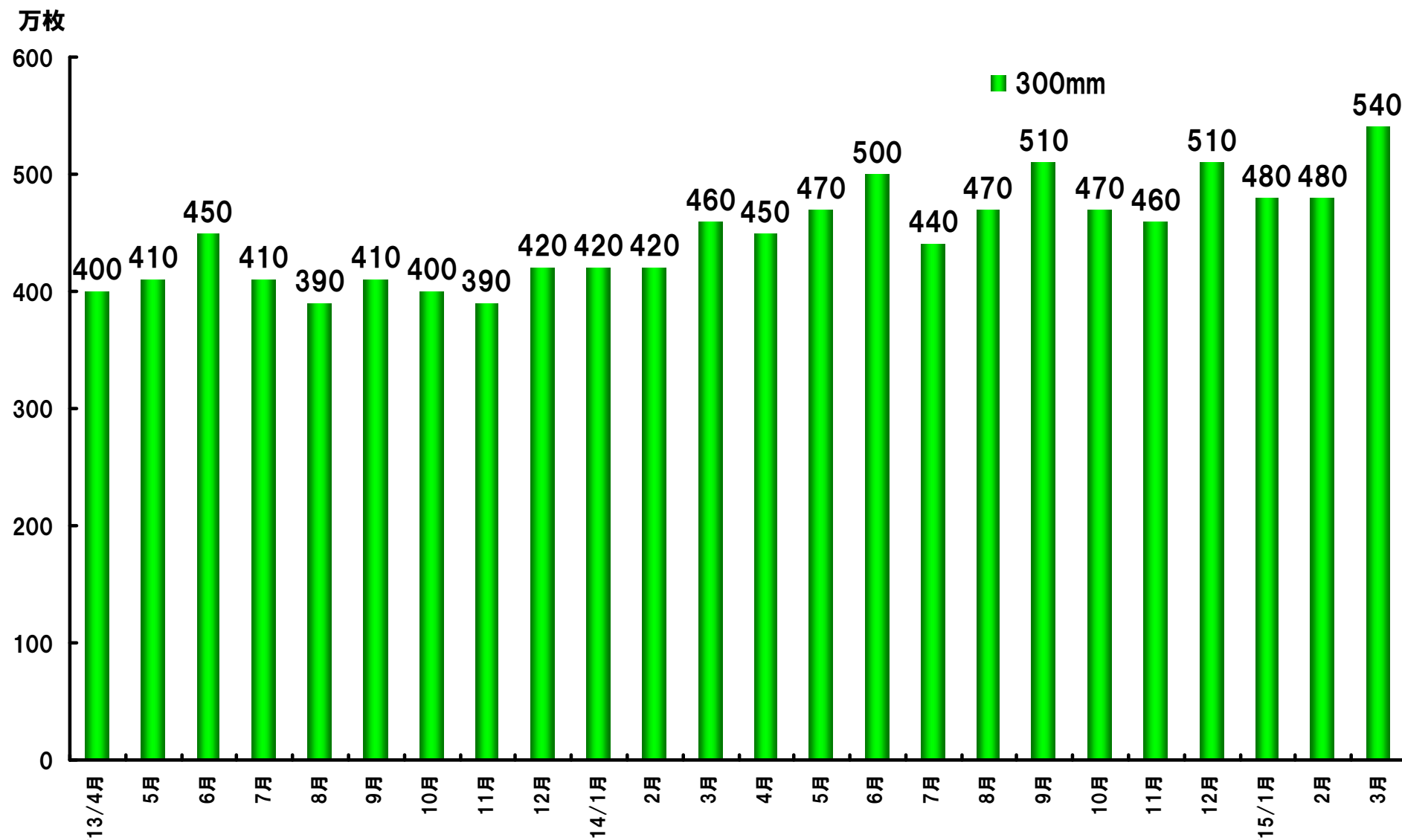
シリコンウェハー出荷面積(四半期)



出所: SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International) 2014年10月

300mmシリコンウェハー出荷枚数(月次)

出所：自社推定



半導体市場規模(地域別)

(億ドル)

